



株式会社 アルバック

2026年6月期 第2四半期 決算説明資料

2025年7月～2025年12月

2026年2月10日

将来見通し等に関する記述についての注意事項

- **将来見通しについて**

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・ディスプレイ・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おください。

- **数字の処理について**

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

- **品目別の各数値について**

管理上の数値ベースで掲載しております。

ULVAC

■ 2026年6月期上期 連結業績概要

- 受注高は半導体・ディスプレイ等の増加により、計画比・前年同期比を上回る
- 売上高・各利益項目は概ね計画通りに着地

■ 中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

- 成長戦略：**半導体電子の成長加速**
レアアース磁石関連ビジネスによる事業拡大の機会到来
- 事業改革・生産改革：迅速に推進中

■ 2026年6月期 業績予想

- 受注高予測を **2,800**億円へ上方修正、過去2番目に高い受注水準
- AI関連ビジネス牽引：半導体電子受注高予測は過去最高水準 **940**億円



2026年6月期上期 連結業績

中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

成長戦略

事業改革・生産改革

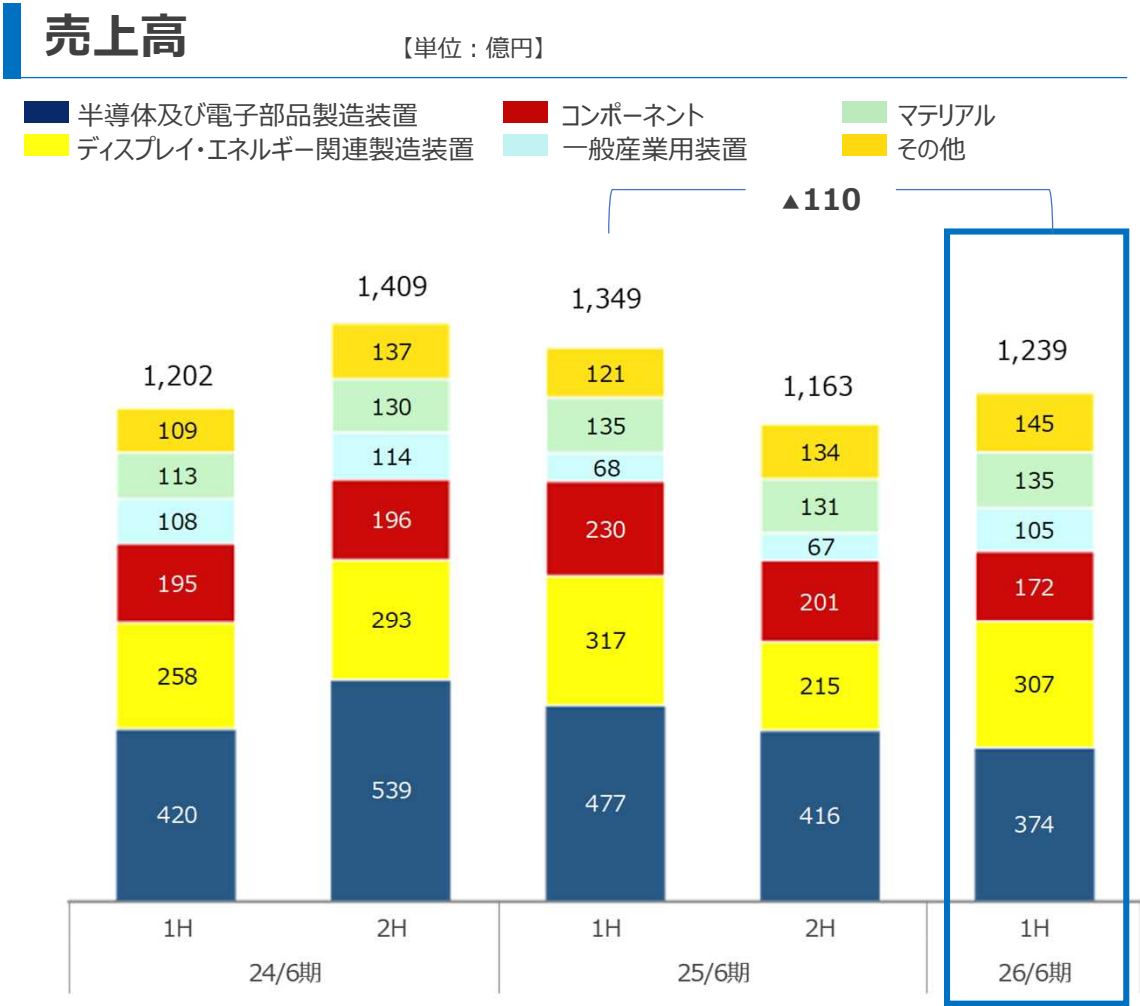
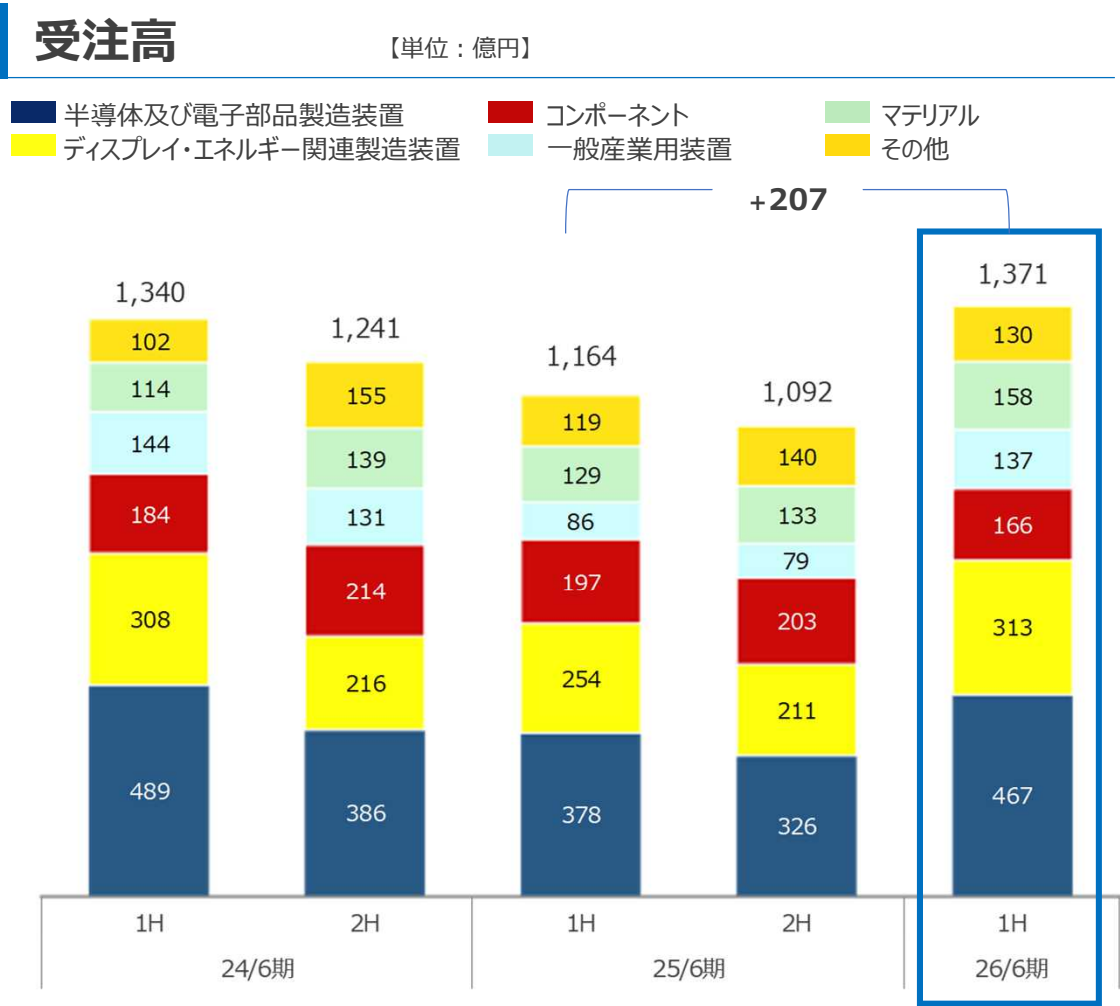
2026年6月期 業績予想

- 受注高は半導体・ディスプレイ等の増加により、計画比・前年同期比を上回る
- 売上高・各利益項目は、概ね計画通りに着地

【単位：億円】	2025/6期						2026/6期							
	1Q	2Q	上期	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	上期					
									計画	実績	計画比		前年同期比	
受注高	509	655	1,164	475	617	2,256	604	767	1,200	1,371	+171	+14%	+207	+18%
売上高	610	739	1,349	529	635	2,512	527	712	1,155	1,239	+84	+7%	-110	-8%
売上総利益	191	238	429	176	193	799	157	207	355	364	+9	+2%	-66	-15%
率	31.3%	32.2%	31.8%	33.3%	30.5%	31.8%	29.7%	29.1%	30.7%	29.4%	-1.4pt	-	-2.5pt	-
販管費	134	142	276	122	136	533	134	145	265	279	+14	+5%	+3	+1%
営業利益	58	96	153	54	58	265	23	62	90	85	-5	-6%	-69	-45%
率	9.4%	13.0%	11.4%	10.2%	9.1%	10.6%	4.3%	8.7%	7.8%	6.8%	-1.0pt	-	-4.6pt	-
経常利益	69	92	161	61	65	286	25	67	90	92	+2	+2%	-69	-43%
率	11.3%	12.4%	11.9%	11.5%	10.2%	11.4%	4.7%	9.4%	7.8%	7.4%	-0.4pt	-	-4.5pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	37	67	104	27	36	167	17	45	65	62	-3	-5%	-42	-40%
率	6.1%	9.0%	7.7%	5.1%	5.6%	6.6%	3.2%	6.4%	5.6%	5.0%	-0.6pt	-	-2.7pt	-

受注高・売上高実績（半期推移）

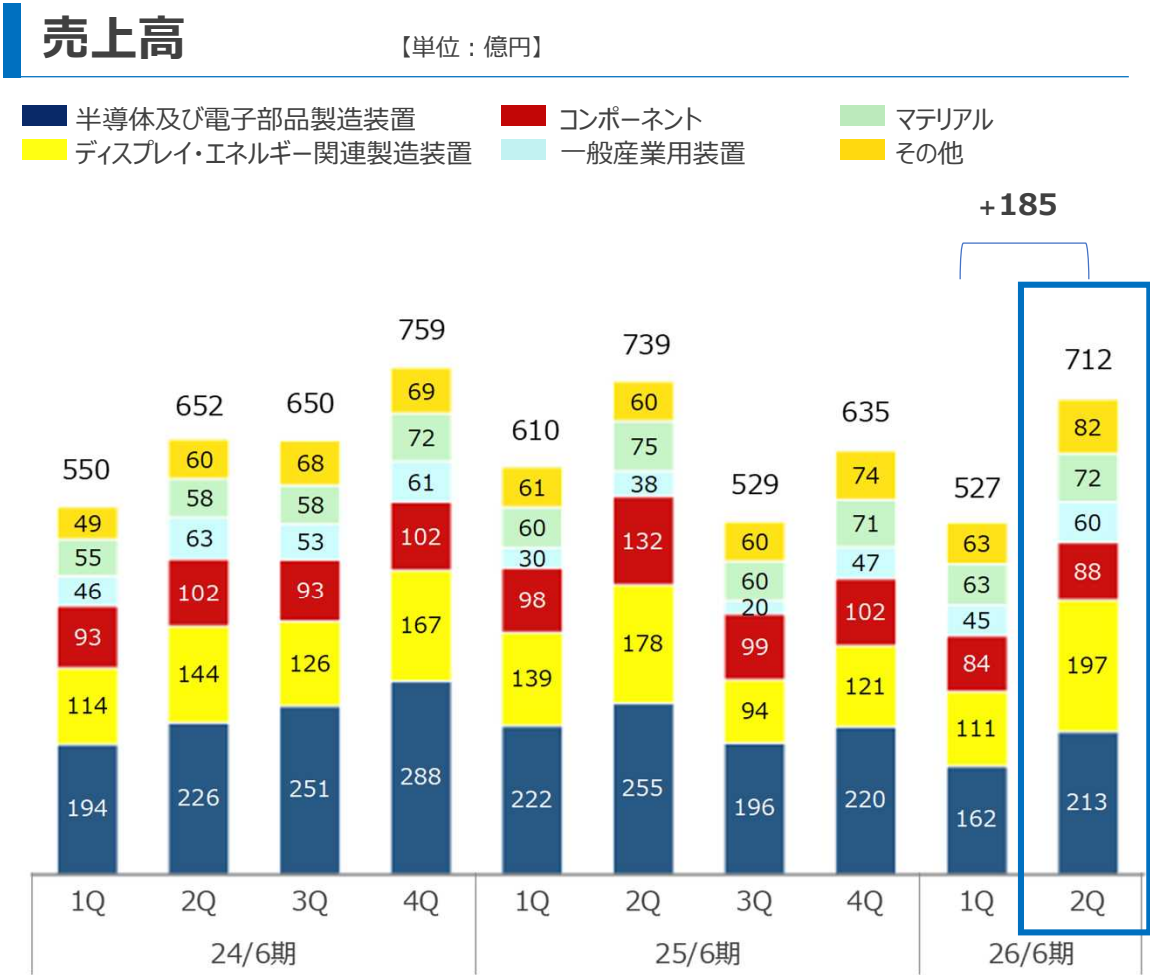
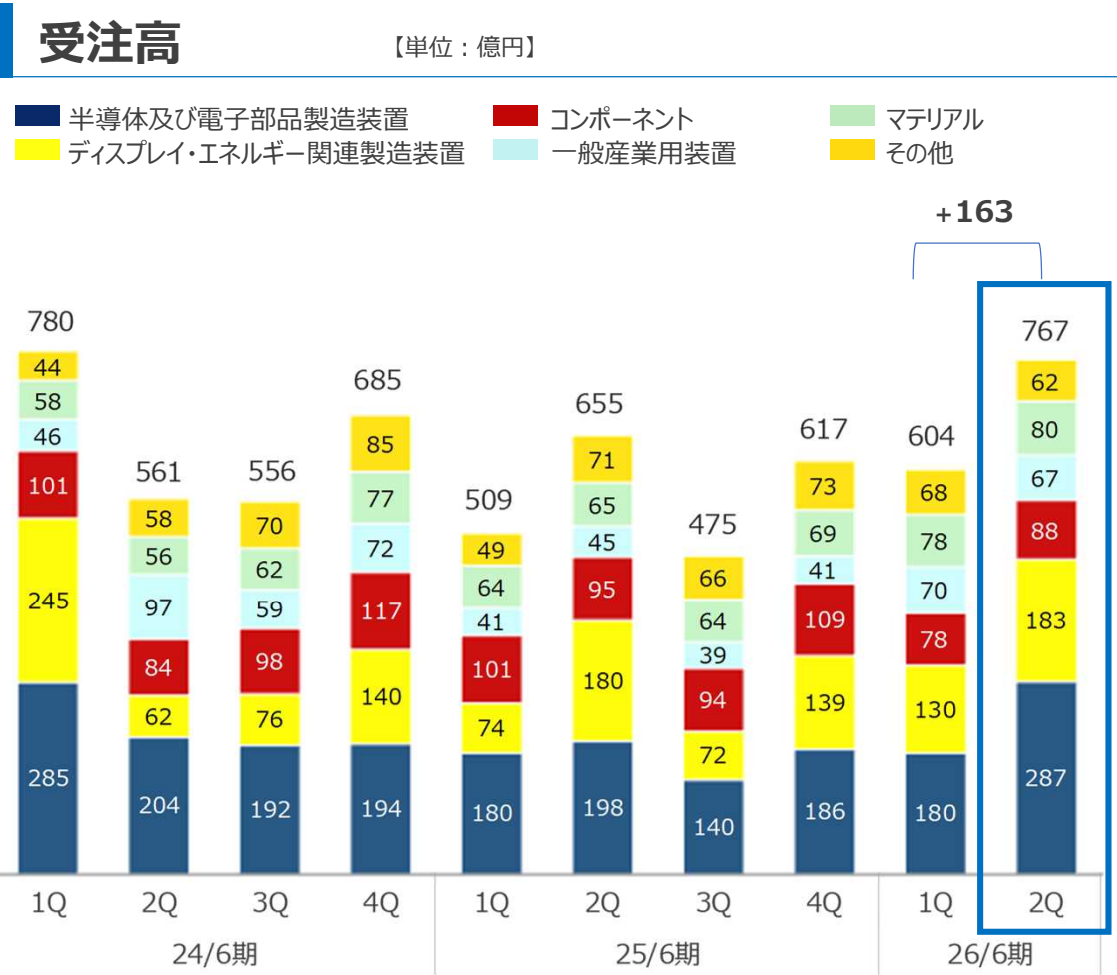
- 受注高：半導体・ディスプレイ案件投資等により、前年同期比＋207億円増加
- 売上高：半導体電子の構成比が一時的に低下も、概ね計画通りの着地



※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

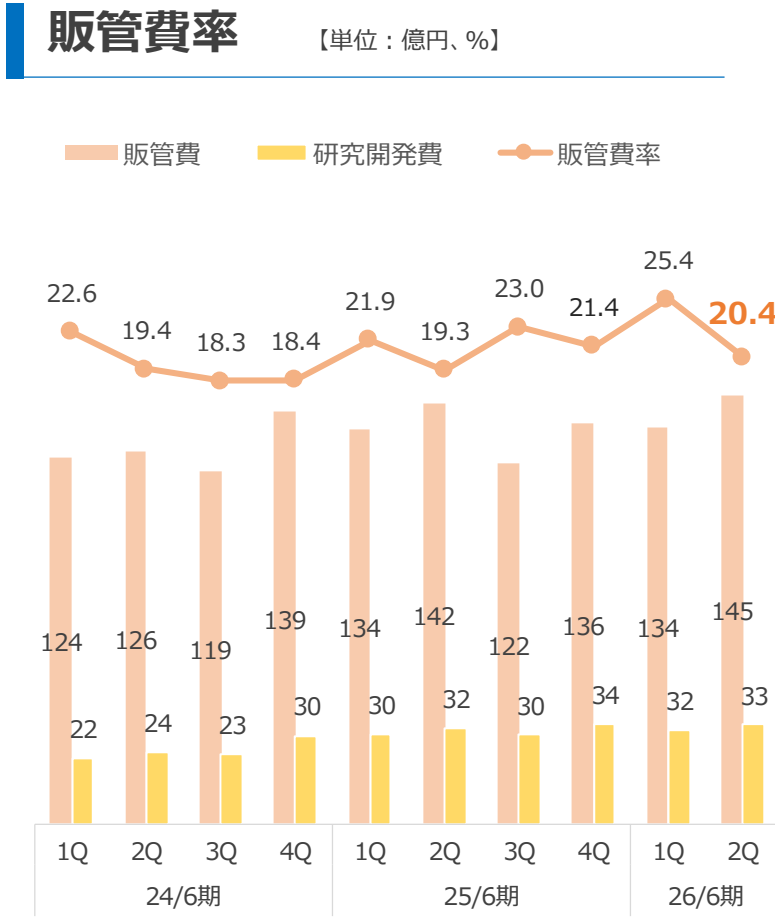
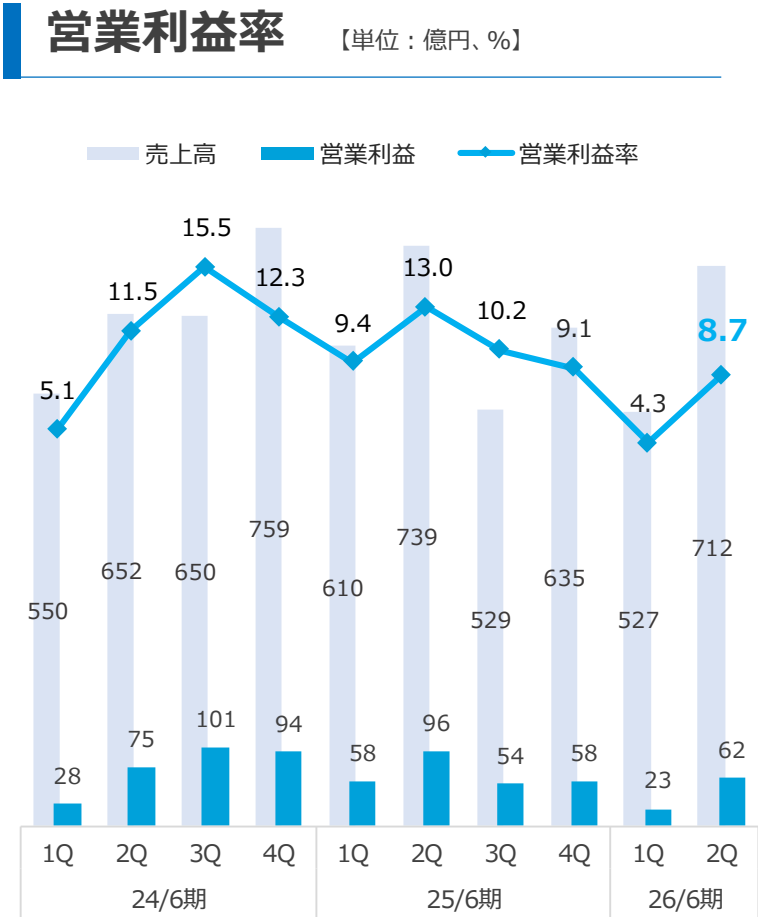
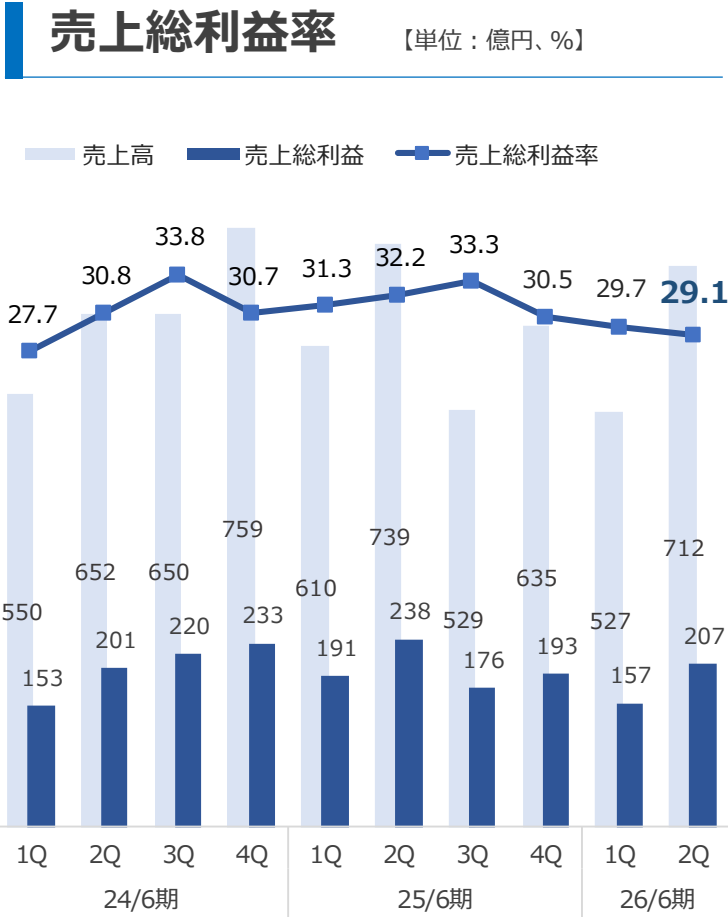
受注高・売上高実績（四半期推移）

- 受注高：半導体・ディスプレイ案件投資等により、前1Q比+163億円増加
- 売上高：下期からの前倒し計上等もあり、全品目で前1Q比増加

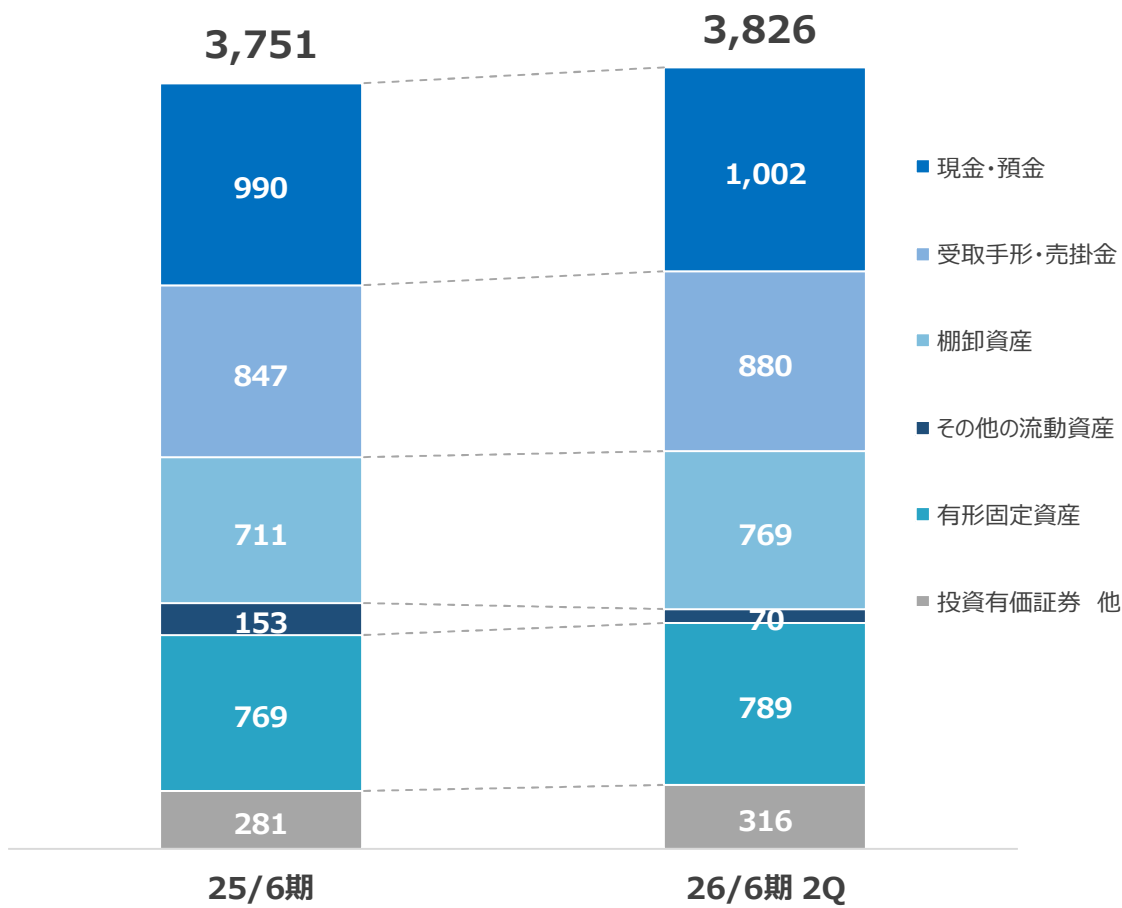


※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更

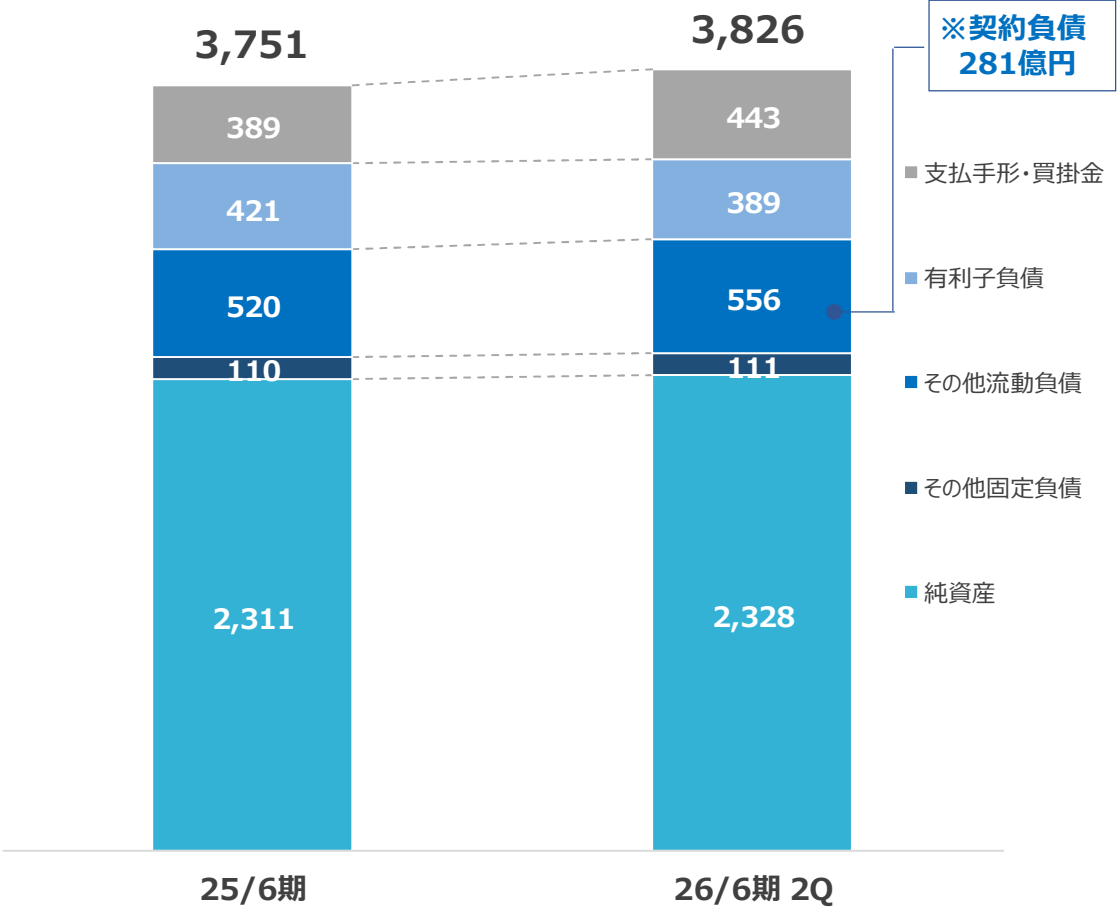
- » 売上総利益率：一時的な製品ミックス変化で前1Q比低下も、下期の半導体関連売上増加等で改善見込み
- » 営業利益率：2Q売上高増加により販管費率が低下し、営業利益率改善



資産【単位：億円】



負債・純資産【単位：億円】





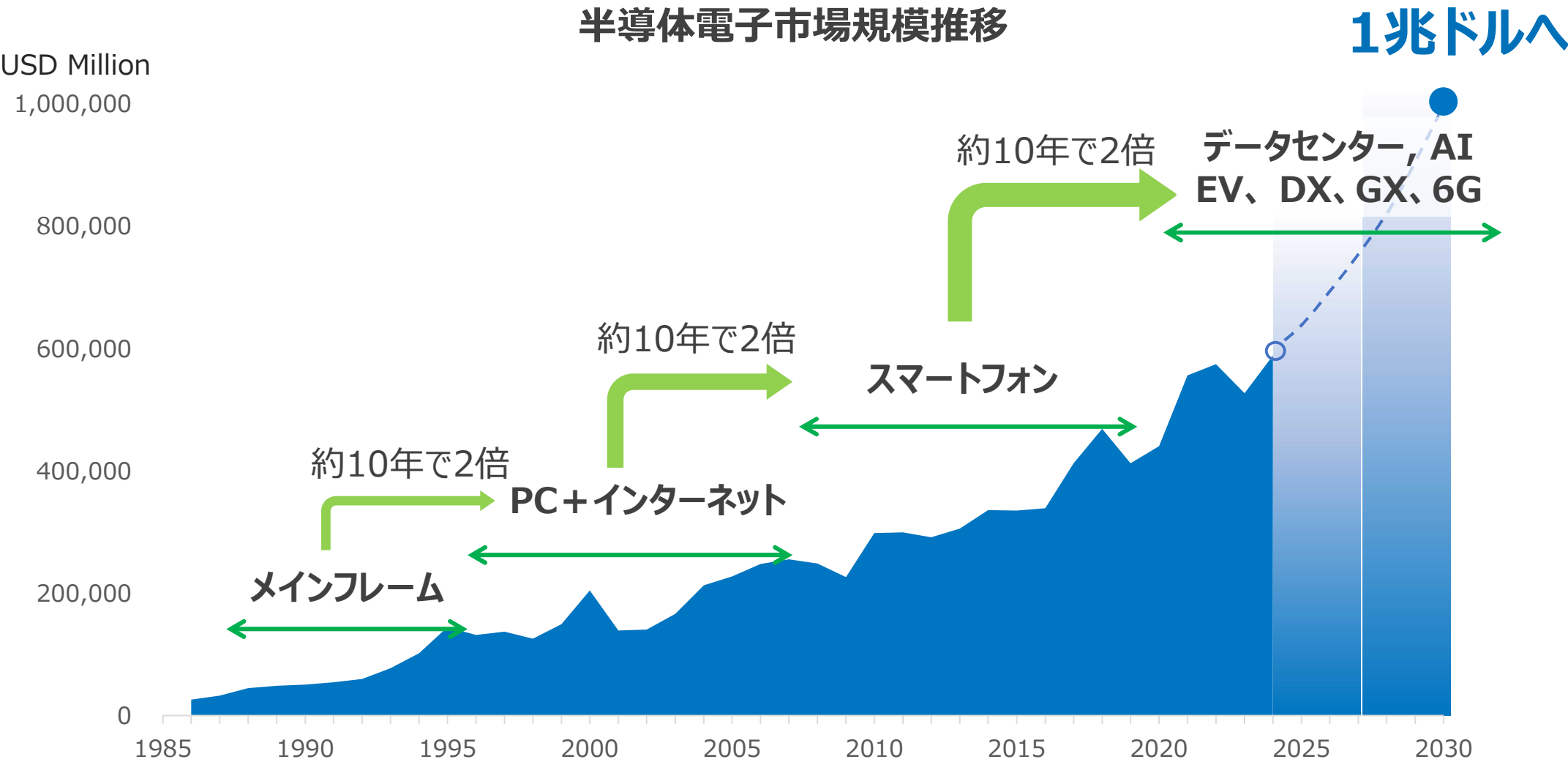
2026年6月期上期 連結業績

中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

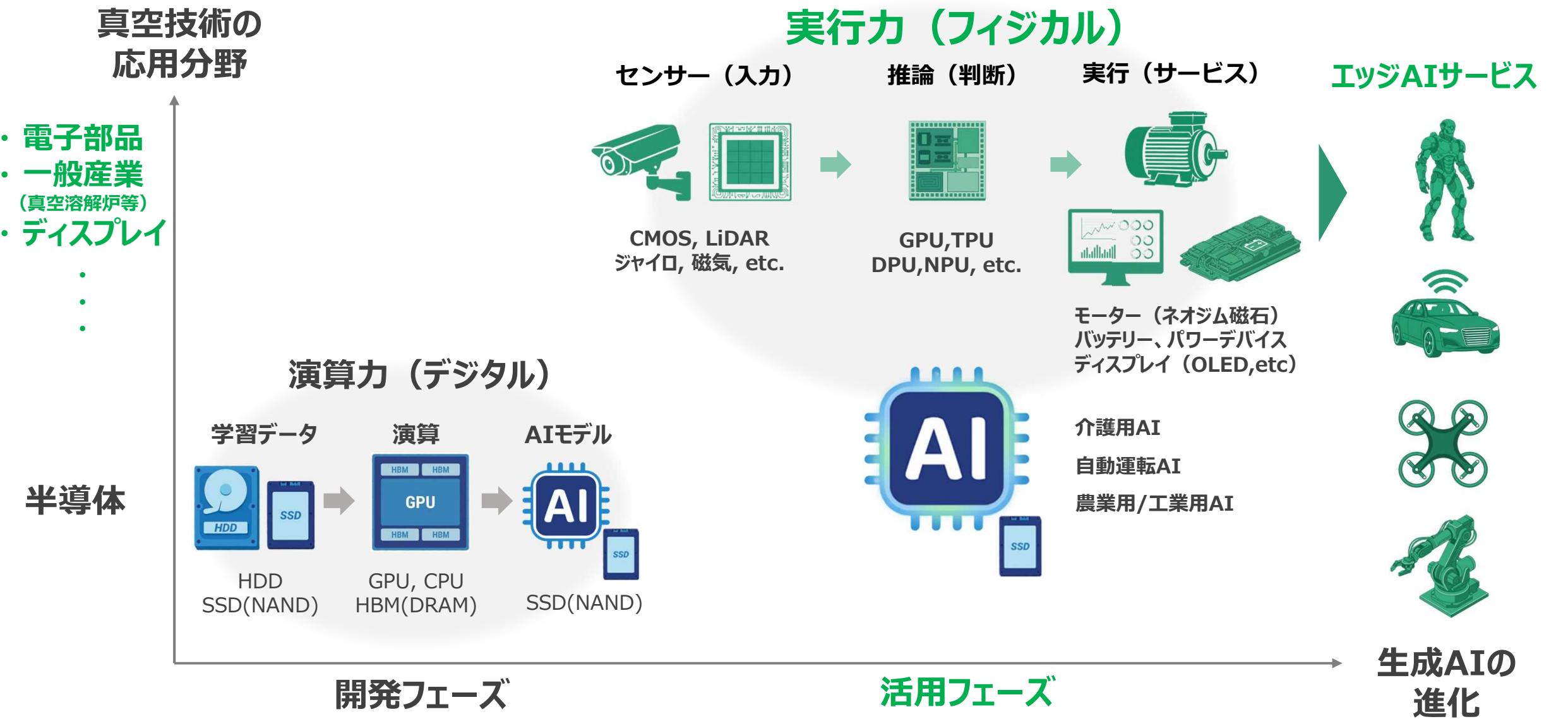
成長戦略

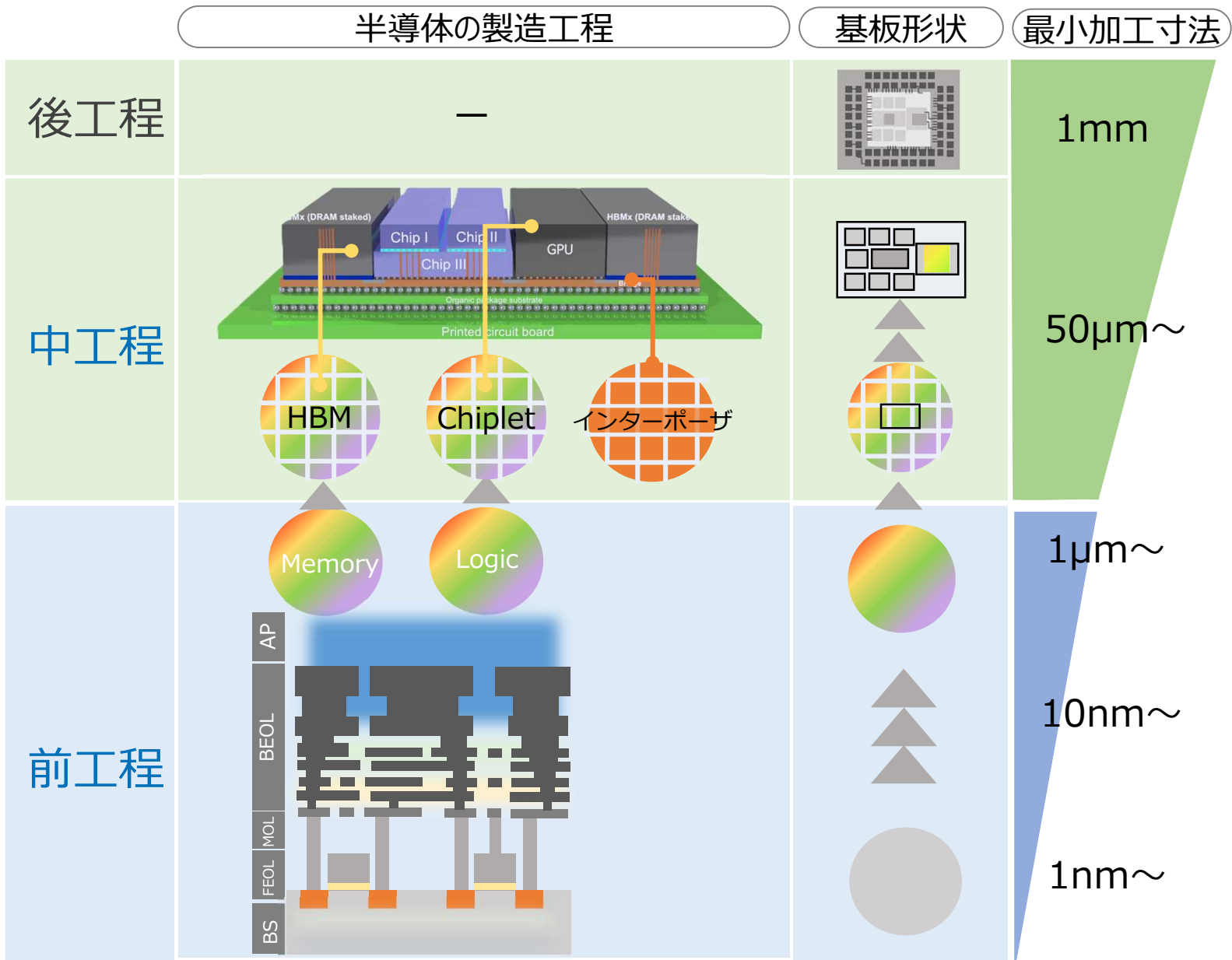
事業改革・生産改革

2026年6月期 業績予想



出所 : WSTS、SEMI





アッシング・エッチング・スパッタリング装置等

- ・ インターポーザ・PLP用デスカム・デスミア処理
- ・ プラズマダイシング用エッチング装置
- ・ プラズマ表面活性化(ハイブリッドボンディング用)
- ・ 親水化プロセス装置
- ・ ガラス加工用エッチング(光導波路形成)
- ・ 電極形成・PLP基板用シードスパッタリング



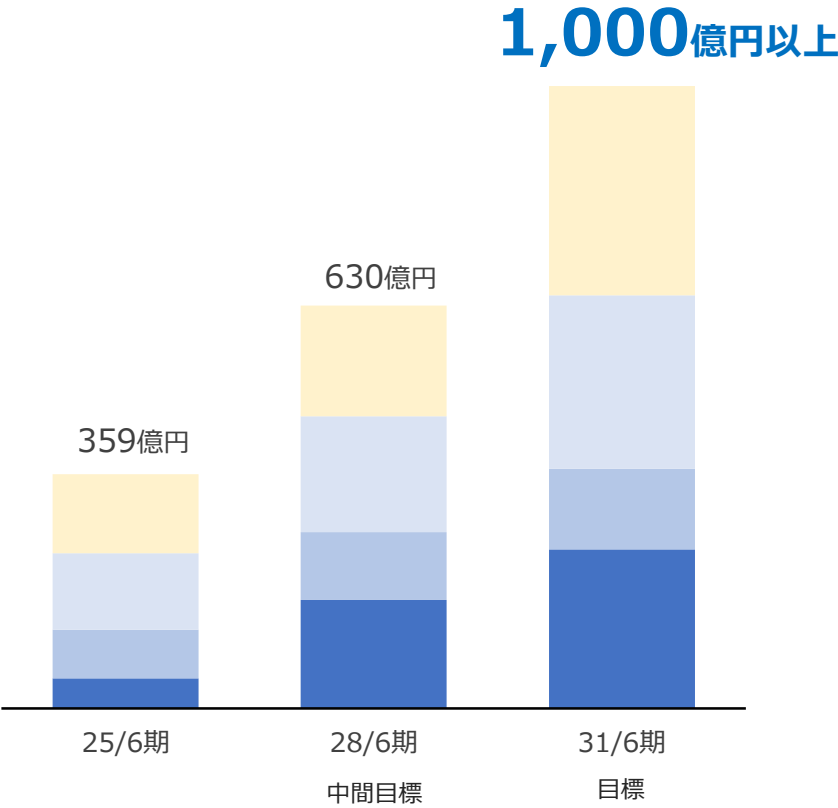
半電融合で
生まれる技術を活用
新たな機会に挑戦

半導体スパッタリング装置

- ・ 新材料・低抵抗成膜
- ・ 金属配線
- ・ ハードマスク

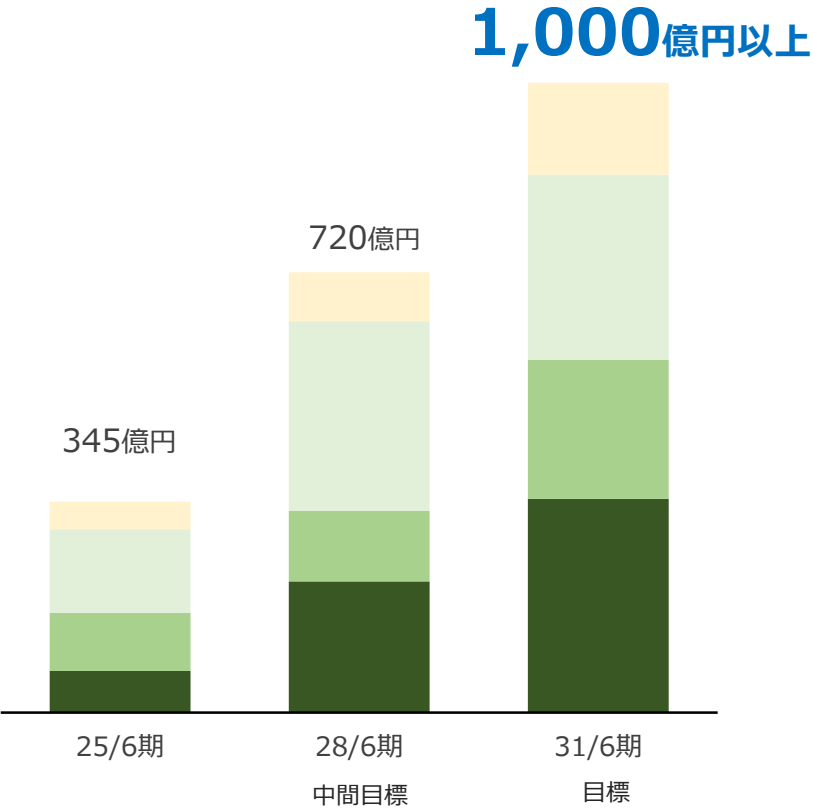
半導体

■ DRAM ■ NAND ■ Logic ■ CS（半導体）



電子

■ Power ■ パッケージング ■ その他 ■ CS（電子）



サプライチェーン多角化による生産拡大への期待



● 既存顧客

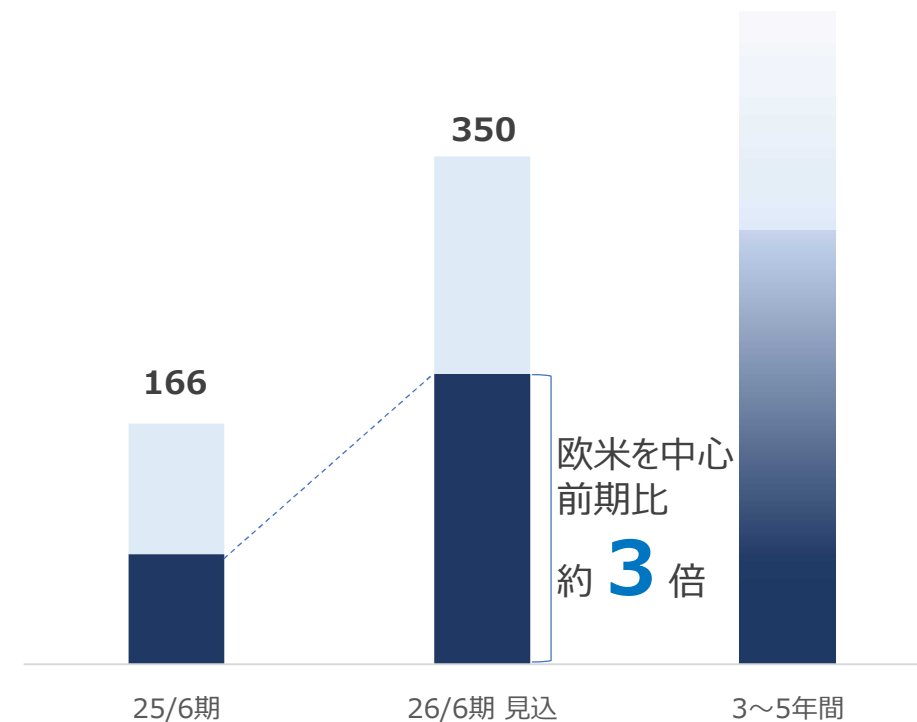
● 潜在顧客

一般産業受注高 【単位：億円】

■ その他（リークテスト装置、凍結乾燥装置等）

■ 真空炉（レアース磁石関連）

350~450/年



欧米を中心
前期比
約 **3** 倍

※26/6期より、リークテスト装置の受注高の分類を、コンポーネントから一般産業へ変更



※当社調べ



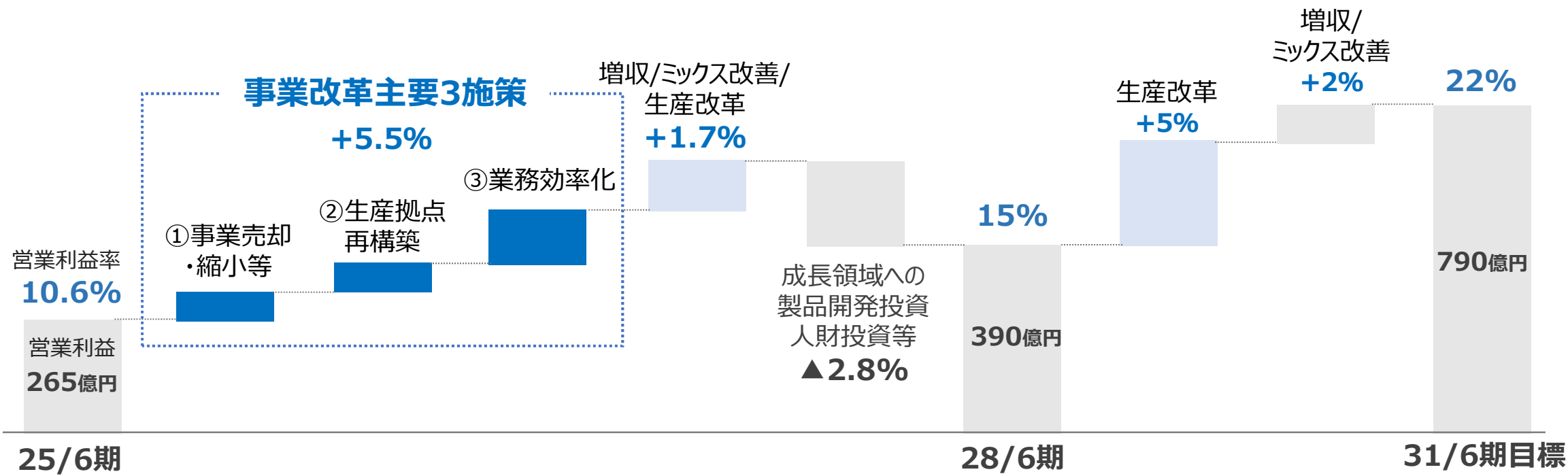
2026年6月期上期 連結業績

中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

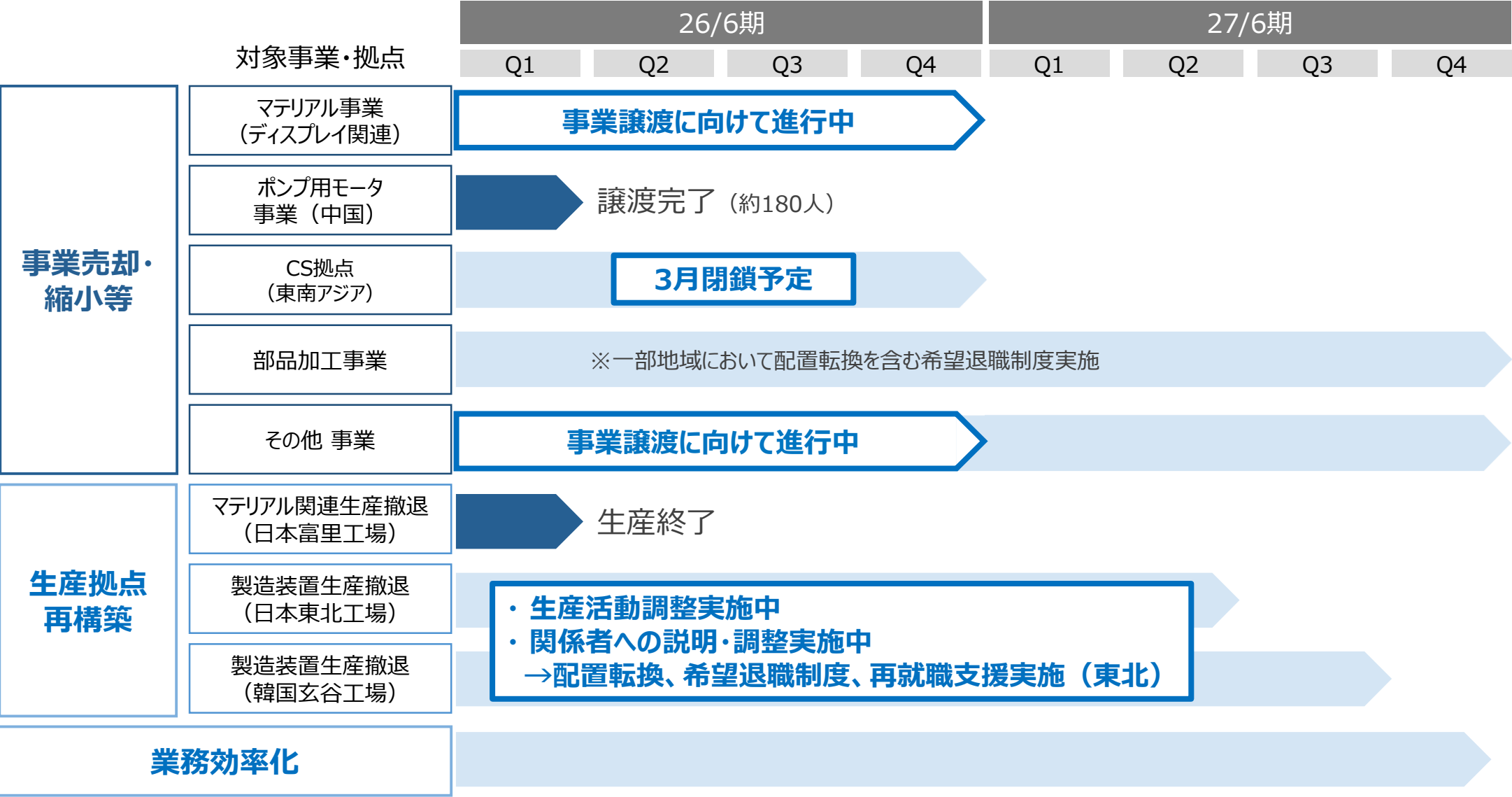
成長戦略

事業改革・生産改革


2026年6月期 業績予想



事業改革	主要3施策	内容
	① 事業売却・縮小等	持分譲渡による非連結化を含み、6事業の売却・縮小等を目指す→1事業譲渡完了。 事業譲渡に向けて進行中、CS拠点（東南アジア）：3月閉鎖予定
	② 生産拠点再構築	工場縮小（1拠点・生産終了済）、工場内一部事業の生産縮小後、他事業転用（2拠点）に向けて対応中
	③ 業務効率化	業務・機能の統合等による業務効率化に向けて対応中
生産改革		MD化による調達・部品共通化による変動費削減、設計・製造効率向上と拠点集約による固定費削減：進行中



モジュラーデザイン(MD)装置 売上高比率



設計
(モジュラーデザイン化)



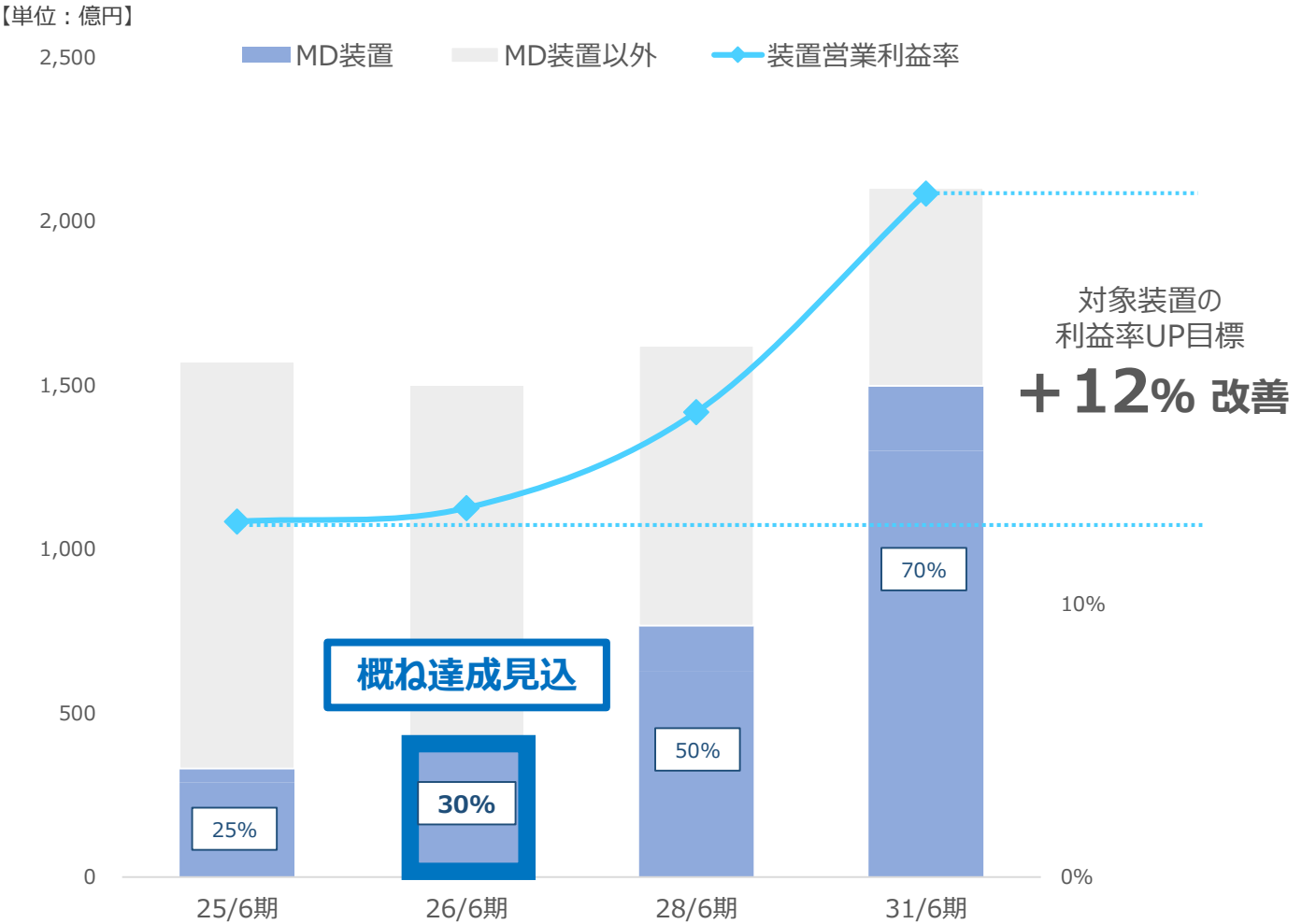
調達
(部品共通化・標準化)



製造
(計画生産・作業標準化)



ITシステム
(基幹システムの整備)





2026年6月期上期 連結業績

中長期経営計画（バリューアッププラン）進捗

成長戦略

事業改革・生産改革

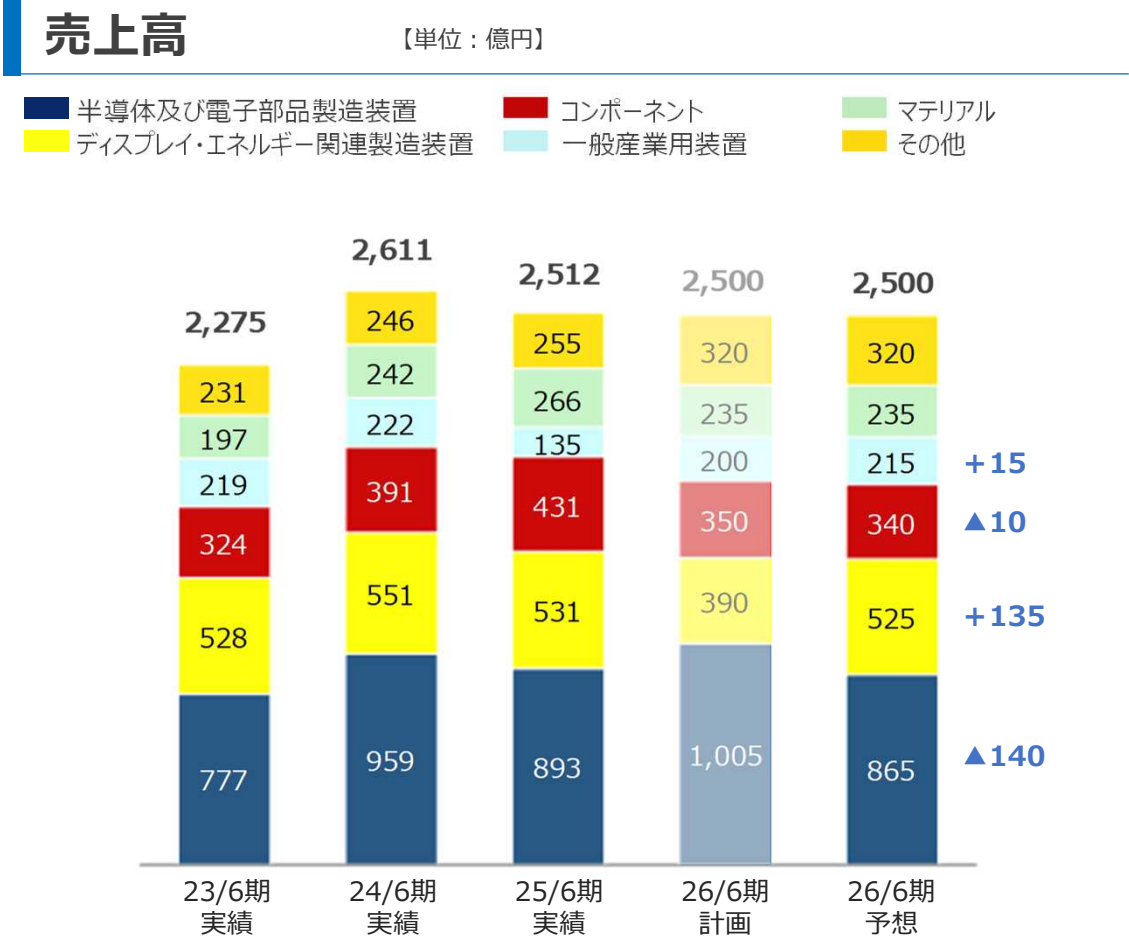
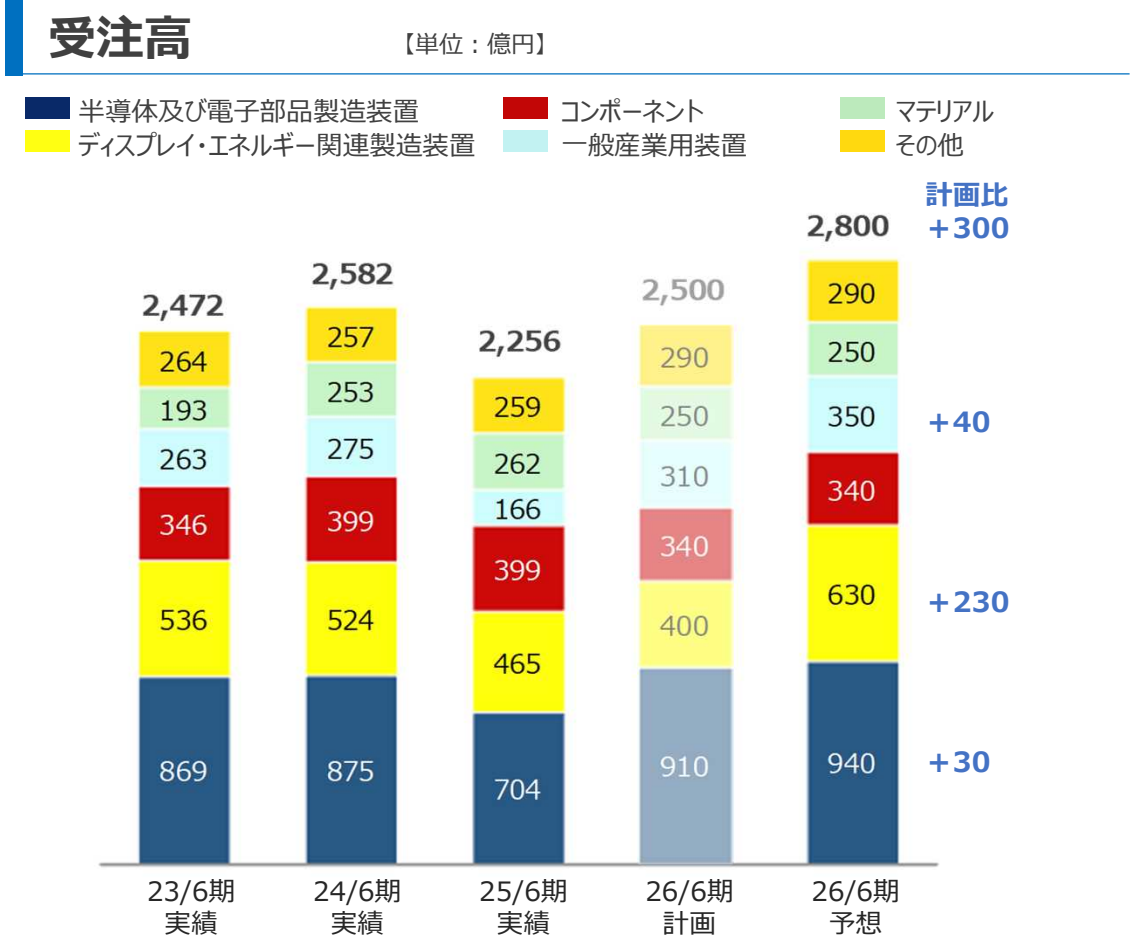
2026年6月期 業績予想

- 受注高：期首計画より+ 300億円上積みし、過去2番目に高い受注水準となる**2,800**億円を見込む
- 売上高・各利益(率)：業績予想・配当予想に修正なし、下期にかけて着実な改善を見込む

【単位：億円】	25/6期	26/6期		前期比	
		上期実績	通期予想	増減額	増減率
受注高	2,256	1,371	期首計画 2,500	+244	+11%
			最新予想 2,800	+544	+24%
売上高	2,512	1,239	2,500	-12	-0.5%
売上総利益	799	364	825	+26	+3%
率	31.8%	29.4%	33.0%	+1.2pt	-
営業利益	265	85	285	+20	+7%
率	10.6%	6.8%	11.4%	+0.8pt	-
経常利益	286	92	285	-1	-0.4%
率	11.4%	7.4%	11.4%	0.0pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	62	200	+33	+20%
率	6.6%	5.0%	8.0%	+1.4pt	-
1株あたり配当金（円）	164		164		

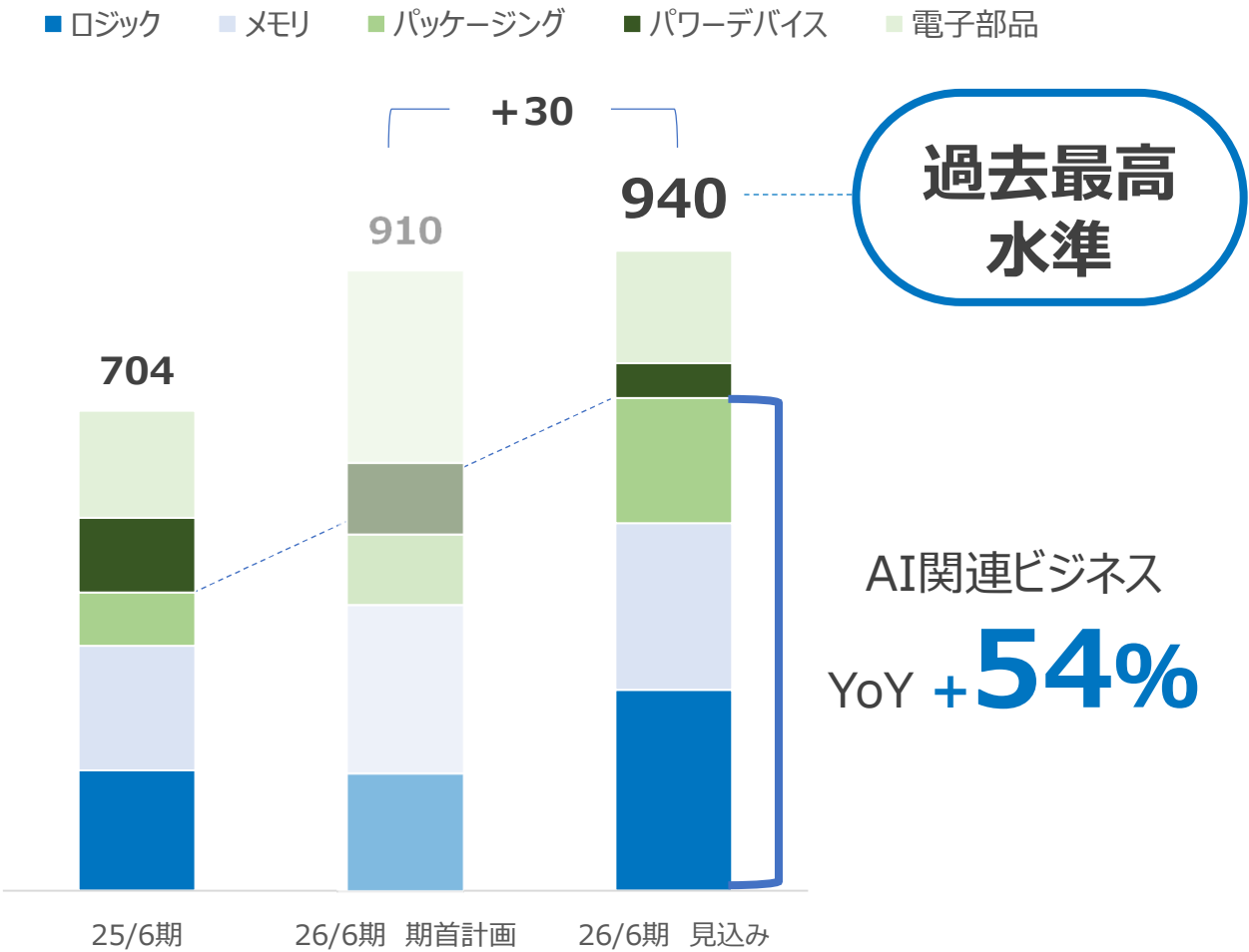
品目別 受注高・売上高予想の修正

- 受注高：過去最高水準を見込む半導体電子、好調なディスプレイ・一般産業をそれぞれ織り込み2,800億円へ修正
- 売上高：計画通り2,500億円据え置き、品目内訳の増減反映



受注高

【単位：億円】



増減要因（計画比）

ロジック（+71%）

- ・ 先端ノード投資堅調、成熟ノードMHM工程の投資拡大
- ・ 北米における外資メーカーによる投資開始

メモリ（±0%）

<DRAM>（+10%）

- ・ AI需要増加によるトップ3メーカーの投資拡大

<NAND・不揮発性メモリ>（▲17%）

- ・ 次世代向け投資継続も計画比やや下回る

パッケージング（+75%）

- ・ 生成AI向けWLP好調持続、PLP開発投資本格化

パワーデバイス（▲50%）

- ・ 顧客からの遅延要請等もあり、受注タイミングが遅延傾向

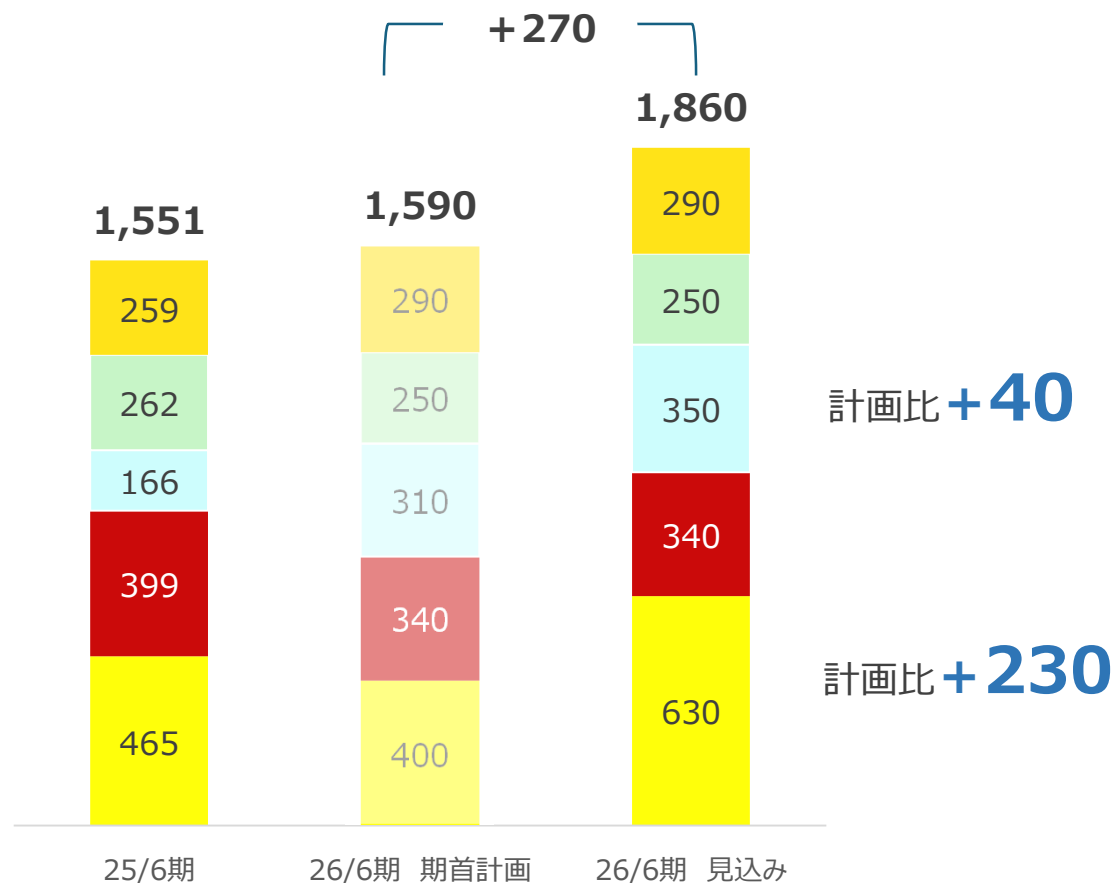
電子部品（▲41%）

- ・ オプトデバイス案件は収益性を重視し、受注機種を限定

受注高

【単位：億円】

■ディスプレイ ■コンポーネント ■一般産業





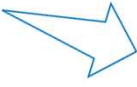



増加要因（計画比）

ディスプレイ（+58%）

- OLED面積拡大化による投資活発化
- LCD・OLEDの設備追加・改造案件による持続的貢献

一般産業（+13%）

- レアアース磁石市場の生産拡大に伴う、投資活発化

品目	投資動向	CY26
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none">DRAM：AI需要増加によるトップ3メーカー投資拡大NAND：次世代向け投資継続ロジック：先端ノード投資堅調、成熟ノードMHM工程の投資拡大、北米における外資メーカーによる投資開始	
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none">生成AI向けWLP好調持続、Hybrid bonding向け投資期待PLP開発投資の本格化光電融合技術の開発加速	
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none">中国大手デバイスメーカー中心に8inchSiC投資の引き合い増加も顧客からの遅延要請等もあり受注タイミング遅延傾向	
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none">OLED面積拡大化による投資増加設備追加・改造案件による持続的貢献	
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none">複合集電体への期待が高まるも、依然として市場形成は不透明銅両面蒸着膜・リチウム膜等の開発継続による中長期的成長期待	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none">半導体電子等における各種設備投資継続により安定基盤ビジネスとして堅調に推移レアアース磁石関連の事業拡大の機会到来	

Samsung Electronics社より「功労賞」を受賞

Samsung Electronicsの「Appreciation Day 2025」で功労賞を受賞

製品品質と生産性の向上に貢献した点が評価



SK Hynix社より「Best Partner Award」を受賞

SK Hynixの「2025 Partners Day」で「Best Partner Award」を受賞

スパッタリング装置「ENTRON」が製造工程でPORを取得し、高い技術信頼性などが評価



TSMC社より「2025 TSMC Excellent Performance Award」を受賞

TSMCより「2025 TSMC Excellent Performance Award」の「Excellent Production Support」を受賞

生産能力拡大や技術協業による優れた生産サポートが評価



当社は、以下のとおり希望退職者の募集を開始することをお知らせします。

1. 希望退職者募集の理由

当社グループを取巻く環境は急激に変化しており抜本的な改革を断行するための中長期 経営計画「バリューアッププラン」にて経営資源の最適化、半導体電子中心の事業ポートフォリオの見直しをスタートいたしました。

今後も当社グループが高い競争優位性・生産性を維持し持続的な高成長・高収益性を実現するためには、バリューアッププランで示した基本方針・目指す姿における成長戦略・事業改革・生産改革に取り組むことが必要であります。それらの実現に向けて配置転換を含めた人員体制の見直しを進めるとともに、従業員一人ひとりの価値観に基づいたライフプランを支援する観点から、今般、希望退職制度を実施することいたしました。

2. 希望退職者募集の概要

- (1) 募集対象者 当社における東北工場、九州工場および同熊本加工センターに属する従業員のうち
当社が定める対象者（約170名）
- (2) 募集人員 特に定めない
- (3) 募集期間 2026年2月10日～2026年4月17日
- (4) 退職予定日 2026年6月30日
- (5) 優遇措置 所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。
また、希望者に対しては再就職支援会社を通じて再就職を支援する。

3. 業績への影響

現時点では応募者数および退職金総額等が未確定であるため、業績に与える影響については精査中であり、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

ULVAC